



## **Infineon Technologies Eckdaten Regensburg**

Gründung des Standortes: 1959 als Siemens Bauelemente-Werk

Gesamtfläche: 237.000 m<sup>2</sup>

Beschäftigte: ca. 2.800 (davon 260 in Burgweinting)

### **Kompletter Produktzyklus zur Herstellung von Halbleiterlösungen:**

Chip-Produktion: ICs für Automobil- und Industrieelektronik (z.B. in Airbag-, ABS-, Motorsteuerungen), für Sicherheitsanwendungen (z.B. in Bankenkarten, Krankenversicherungskarten) und für drahtlose und drahtgebundene Kommunikation (z.B. in Handys, Breitbandlösungen)

Chipkarten-odulmontage: Entwicklung und Fertigung von Modulen für Chipkarten-Anwendungen in Regensburg-Burgweinting  
Leitstandort für Technologie, Innovation und Marketing

Montage und Prüffeld: Leitstandort für Multichip-Module und Sensoren

Weltweites Kompetenzzentrum für Montageprozesse und Verbindungstechnologien